



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月29日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員

(氏名) 原田 芳輝

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成26年11月7日

配当支払開始予定日

平成26年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	294,273	15.6	30,115	—	31,773	—	20,016	708.2
26年3月期第2四半期	254,500	△4.5	△1,822	—	588	△96.2	2,476	△59.3

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 23,321百万円 (165.3%) 26年3月期第2四半期 8,789百万円 (362.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期第2四半期	111.68	111.42
26年3月期第2四半期	13.82	13.79

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年3月期第2四半期	801,310	595,876	74.1
26年3月期	828,591	590,613	69.8

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 594,160百万円 26年3月期 578,091百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00
27年3月期	10.00	30.00			

*当社はアプライド マテリアルズとの経営統合を発表しておりますが、日本、米国その他の国における適用ある競争法に基づく関係当局の承認等を条件としておりますため、経営統合の効力発生日が未定であります。このような状況に鑑み、平成27年3月期第3四半期以降の配当予想は公表しておりません。

3. 平成27年3月期の連結業績予想について(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

平成27年3月期の通期連結業績予想につきましては、アプライド マテリアルズとの経営統合効力発生日が未定であることから、開示しておりませんが、当社グループベースの下半期といたしましては、売上高3,040億円、営業利益430億円を想定しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期2Q	180,610,911 株	26年3月期	180,610,911 株
27年3月期2Q	1,359,423 株	26年3月期	1,408,950 株
27年3月期2Q	179,222,274 株	26年3月期2Q	179,187,591 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成26年10月29日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、総じて緩やかな回復基調が続いております。また、日本におきましては消費税率引き上げの影響があったものの、景気は概ね緩やかな回復を示しております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、新型スマートフォン発売による半導体需要や、中国をはじめとする低価格帯のスマートフォン市場の拡大がみられ、また、クラウドコンピューティングの普及やビッグデータ活用の拡がりを受けてデータセンター向けサーバー需要が伸びる等、電子部品市場は引き続き堅調に推移しております。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,942億7千3百万円(前年同期比15.6%増)、営業利益301億1千5百万円(前年同期は18億2千2百万円の営業損失)、経常利益317億7千3百万円(前年同期は5億8千8百万円の経常利益)、また、四半期純利益は200億1千6百万円(前年同期比708.2%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、当社は本年4月及び5月に東京エレクトロン デバイス株式会社の一部を売却いたしました。これにより、当社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動し、第1四半期連結会計期間から、当社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外しました。上述の連結売上高の前年同期比増減率(15.6%増)につきましては、当社を連結の範囲から除外した影響が反映されたものであります。

① 半導体製造装置

スマートフォンの高機能化と堅調な販売、データセンター向けサーバー需要などを背景に、DRAMやNANDフラッシュメモリ等の電子部品の需要は好調であり、半導体メーカーの設備投資は順調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,726億2千6百万円(前年同期比40.0%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

スマートフォン向けを中心とした中小型液晶パネル需要に加え、中国における大型液晶パネル向け設備投資も続いており、FPD製造装置市場は引き続き堅調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、190億2千9百万円(前年同期比102.6%増)となりました。

③ PV(太陽光パネル)製造装置

太陽光パネル製造装置の新規販売活動の撤退を決定しておりますが、受注済み装置に対する工事進行基準による売上高等の計上により、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、23億2千5百万円(前年同期比29.3%減)となりました。

④ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億9千2百万円(前年同期比13.2%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
売上高	254,500	357,670
半導体製造装置	194,773	284,068
日本	33,233	43,191
米国	44,817	59,546
欧州	13,575	16,060
韓国	28,864	44,538
台湾	56,059	74,192
中国	9,635	39,261
東南アジア他	8,587	7,277
F P D製造装置	9,393	18,923
P V製造装置	3,288	517
電子部品・情報通信機器	46,786	53,939
その他	258	221
営業利益(△損失)	△1,822	34,027
経常利益	588	34,898
四半期純利益(△損失)	2,476	△21,885

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
294,273	151,325	142,948
272,626	136,126	136,500
39,505	13,421	26,084
67,696	33,790	33,906
24,720	12,530	12,189
37,146	22,451	14,695
76,808	38,456	38,352
20,981	13,911	7,069
5,768	1,565	4,202
19,029	13,929	5,099
2,325	1,102	1,223
—	—	—
292	167	125
30,115	17,069	13,045
31,773	16,913	14,860
20,016	11,835	8,181

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	185,142	284,943
F P D製造装置	10,815	25,232
P V製造装置	3,358	517
合計	199,316	310,693

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
247,355	124,318	123,037
10,453	7,419	3,033
2,272	1,081	1,191
260,081	132,818	127,262

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	249,031	297,901
F P D製造装置	20,843	20,493
P V製造装置	2,286	2,017
電子部品・情報通信機器	48,607	54,533
その他	258	221
合計	321,026	375,167

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
279,771	137,297	142,474
19,130	14,280	4,849
550	541	8
—	—	—
292	167	125
299,744	152,286	147,457

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位：百万円)

	前期		当期	
	第2Q末	期末	第1Q末	第2Q末
半導体製造装置	196,081	209,914	211,085	217,059
F P D製造装置	27,449	29,019	29,371	29,121
P V製造装置	7,494	8,994	8,433	7,219
電子部品・情報通信機器	16,606	17,200	—	—
その他	—	—	—	—
合 計	247,632	265,129	248,889	253,399

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ282億8千2百万円減少し、5,932億1千万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少270億1千9百万円、たな卸資産の減少259億9千万円、現金及び預金の減少77億4百万円、未収消費税等の減少68億5百万円、有価証券に含まれる短期投資の増加386億7千9百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から7億7百万円減少し、1,116億3千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から18億8千8百万円減少し、276億6千7百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から35億9千6百万円増加し、687億9千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から272億8千1百万円減少し、8,013億1千万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ247億9千9百万円減少し、1,457億1千万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少137億8千2百万円、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外による短期借入金の減少115億3千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ77億4千4百万円減少し、597億2千3百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ52億6千2百万円増加し、5,958億7千6百万円となりました。主として、四半期純利益200億1千6百万円を計上したことによる増加、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外等による少数株主持分の減少106億5千万円、前期の期末配当及び当期の第1四半期配当62億7千2百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は74.1%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,202億7千4百万円増加し、2,250億7千1百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資740億4千9百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ309億7千4百万円増加し、2,991億2千1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ435億5千5百万円増加の433億3千8百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益291億1百万円、減価償却費97億3千7百万円、売上債権の減少53億2千7百万円、たな卸資産の減少51億8千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額153億2百万円、仕入債務の減少65億3千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入893億3百万円、有形固定資産の取得による支出65億9千7百万円により、前年同期の71億4千8百万円の収入に対し853億5千8百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払62億7千2百万円により、前年同期の11億2百万円の収入に対し64億5千8百万円の支出となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の通期連結業績予想につきましては、経営統合の効力発生日が未定であるため開示しておりませんが、当社グループベースの下半期といたしましては、売上高3,040億円、営業利益430億円を想定しております。ご参考までに、上半期の実績と下半期の想定値を合算すると、通期ベースでは売上高5,982億円、営業利益731億円となります。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響は、軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	56,345	48,641
受取手形及び売掛金	129,032	102,012
有価証券	211,800	250,480
商品及び製品	114,289	84,279
仕掛品	38,074	40,952
原材料及び貯蔵品	15,912	17,053
その他	57,538	50,602
貸倒引当金	△1,502	△813
流動資産合計	621,492	593,210
固定資産		
有形固定資産	112,344	111,636
無形固定資産		
のれん	9,400	8,990
その他	20,155	18,677
無形固定資産合計	29,556	27,667
投資その他の資産		
その他	67,065	70,674
貸倒引当金	△1,866	△1,878
投資その他の資産合計	65,199	68,795
固定資産合計	207,099	208,100
資産合計	828,591	801,310
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	53,667	39,885
短期借入金	11,531	-
未払法人税等	14,014	11,032
製品保証引当金	10,072	10,778
その他の引当金	8,642	7,813
その他	72,581	76,200
流動負債合計	170,509	145,710
固定負債		
その他の引当金	582	374
退職給付に係る負債	53,448	49,026
その他	13,436	10,322
固定負債合計	67,468	59,723
負債合計	237,978	205,434
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	436,174	448,647
自己株式	△9,478	△9,146
株主資本合計	559,679	572,484
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,592	5,555
繰延ヘッジ損益	60	75
為替換算調整勘定	5,777	9,976
退職給付に係る調整累計額	6,981	6,068
その他の包括利益累計額合計	18,411	21,675
新株予約権	1,643	1,487
少数株主持分	10,878	227
純資産合計	590,613	595,876
負債純資産合計	828,591	801,310

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
売上高	254,500	294,273
売上原価	174,453	186,825
売上総利益	80,046	107,448
販売費及び一般管理費		
研究開発費	38,440	34,951
その他	43,428	42,381
販売費及び一般管理費合計	81,869	77,333
営業利益又は営業損失(△)	△1,822	30,115
営業外収益		
受取利息	677	551
補助金収入	907	478
その他	2,397	1,233
営業外収益合計	3,981	2,264
営業外費用		
為替差損	1,338	535
その他	232	69
営業外費用合計	1,570	605
経常利益	588	31,773
特別利益		
固定資産売却益	79	120
投資有価証券売却益	-	54
その他	18	-
特別利益合計	98	175
特別損失		
減損損失	873	-
子会社株式売却損	-	1,609
拠点再編費用	-	698
その他	135	540
特別損失合計	1,009	2,848
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△321	29,101
法人税等	△2,903	9,058
少数株主損益調整前四半期純利益	2,582	20,042
少数株主利益	105	26
四半期純利益	2,476	20,016

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,582	20,042
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	368	△37
繰延ヘッジ損益	65	81
為替換算調整勘定	5,773	4,178
退職給付に係る調整額	-	△892
持分法適用会社に対する持分相当額	-	△51
その他の包括利益合計	6,206	3,278
四半期包括利益	8,789	23,321
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,619	23,280
少数株主に係る四半期包括利益	169	40

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整 前四半期純損失 (△)	△321	29,101
減価償却費	12,749	9,737
のれん償却額	2,139	544
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,474	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	-	757
子会社株式売却損益 (△は益)	-	1,609
売上債権の増減額 (△は増加)	△16,352	5,327
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△20,314	5,186
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,058	△6,535
未収消費税等の増減額 (△は増加)	7,529	4,740
前受金の増減額 (△は減少)	8,201	4,343
その他	△6,975	2,861
小計	△2,811	57,671
利息及び配当金の受取額	2,262	984
利息の支払額	△39	△15
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	371	△15,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	△217	43,338
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	△48	-
短期投資の増減額 (△は増加)	13,984	89,303
有形固定資産の取得による支出	△5,246	△6,597
無形固定資産の取得による支出	△1,356	△128
投資有価証券の売却による収入	1	1,084
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入	-	1,726
その他	△186	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,148	85,358
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	4,101	-
長期借入れによる収入	2,000	-
配当金の支払額	△4,658	△6,272
その他	△339	△186
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,102	△6,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,158	△1,963
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,875	120,274
現金及び現金同等物の期首残高	85,313	104,797
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同 等物の増減額 (△は減少)	△1,206	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	89,982	225,071

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」及び「PV(太陽光パネル)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っていましたが、平成26年3月末をもって新規装置の製造開発、販売活動を停止し、納入済み装置に対するサポートのみを行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置	PV 製造装置				
売上高	272,626	19,029	2,325	5,682	299,663	△5,390	294,273
セグメント利益 又は損失(△)	60,644	△612	△7,728	653	52,957	△23,856	29,101

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等であります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△23,856百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△8,146百万円及び、経営統合に係る費用△6,107百万円等であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

当社の連結子会社でありました東京エレクトロン デバイス(株)が持分法適用関連会社へ異動したことに伴い、第1四半期連結会計期間より、同社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外し、同社に係る持分法投資損益はセグメント利益又は損失の調整額に含めております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。